

# はんだ付け条件 Soldering Conditions

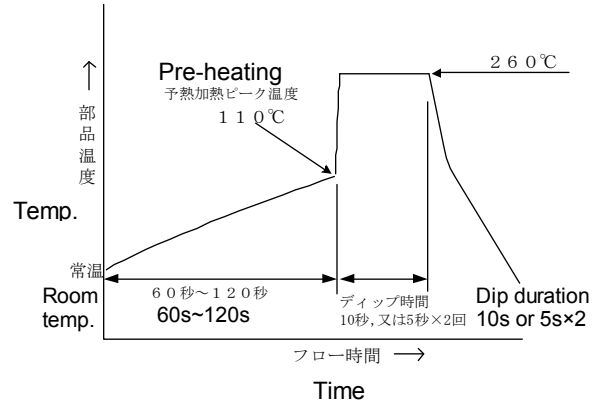
## ◆ はんだ耐熱条件 (ディスクリット抵抗器) -Soldering Conditions (Lead Type Resistors) -

### フローはんだ -Flow soldering-

- ・プリヒート: 110±5°C
- ・ピーク温度・時間 : 260°C、1 次、2 次噴流の合計 10 秒以内
- ・温度プロファイル図(例): 右図参照
  - ・Pre-heating: 110°C MAX
  - ・Peak temperature/Duration: 260°C, Within 10sec (1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> wave total)
  - ・Temperature profile: See the right chart.

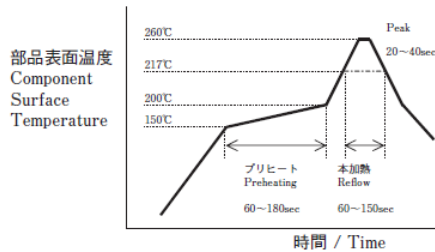
### 手はんだ -Iron soldering-

- コテ先温度 380°C 5 秒 1 回/端子
- 380°C, 5 seconds, once/terminal



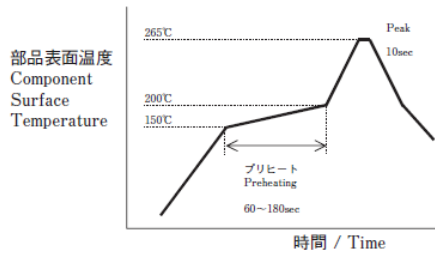
## ◆ はんだ耐熱条件 (チップ抵抗器) -Soldering Conditions (Chip Resistors) -

リフロープロファイル(3回以内) / Reflow profile (max. 3 cycles)



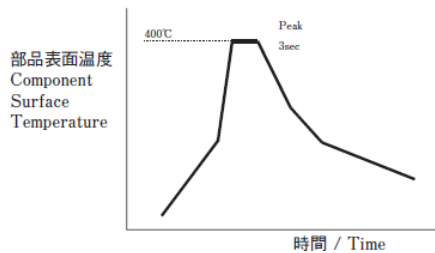
	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
プリヒート / Preheat	150~200°C, 60~180sec
本加熱 / Reflow	Min. 217°C, 60~150sec
ピーク / Peak	260°C, 20~40sec

フロープロファイル(3回以内) / Flow profile (max. 3 cycles)



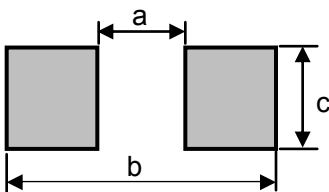
	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
プリヒート / Preheat	150~200°C, 60~180sec
ピーク / Peak	265°C, 10sec

はんだごて条件 / Soldering iron condition



	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
はんだごて / Soldering iron	400°C, 3sec

## ◆ 推奨ランドパターン (チップ抵抗器) -Recommended Solder Pad Dimensions (Chip Resistors)-



型名 Type	mm size	Inch size	a	b	c
CR CRU CLR CHR CRS CRF CRA	0603	0201	0.26	0.72	0.32
	1005	0402	0.50	1.30	0.50
	1608	0603	0.90	2.60	0.70
	2012	0805	1.35	3.45	1.10
	3216	1206	2.20	4.70	1.40
	3225	1210	2.20	5.20	2.15
	5025	2010	3.70	6.20	2.15
	4532	1812	3.40	5.80	2.75
6332	2512	4.70	7.60	2.75	